© 2011 р. Л.Ф. Політанський, В.В. Лесінський

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Чернівці

ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МОН-ТРАНЗИСТОРІВ З ПОДВІЙНОЮ ДИФУЗІЄЮ

Досліджено вплив нерівномірного розподілу домішок бору і фосфору вздовж каналу в *p*канальній області МОН-транзисторів, сформованих методом подвійного дифузії (ПМОНтранзистори) на його порогову напругу і напругу змикання стоку з витоком. Профіль нерівномірного розподілу домішок апроксимований експоненціальними залежностями від координати в *p*-канальній області структури.

Ключові слова: ПМОН-транзистор, порогова напруга, легування, *p-n* перехід.

Исследовано влияние неравномерного распределения примесей бора и фосфора вдоль канала в *p*-канальной области ДМОП-транзисторов, сформированных методом двойной диффузии (ДМОПтранзисторы) на его пороговое напряжение и напряжение смыкания стока с истоком. Профиль неравномерного распределения примесей аппроксимирован экспоненциальными зависимостями от координаты в *p*-канальной области структуры.

Ключевые слова: ДМОП-транзистор, пороговое напряжение, легирование, *p-n* переход.

There has been studied influence of maldistribution of boron and phosphate impurities along the channel length in *p*-channel region of MOS-transistors formed by means of double diffusion (DMOS-transistors) on its threshold voltage and drain and source pinch-off voltage. The impurities maldistribution profile is approximated by exponential dependence on the coordinate of *p*-channel region structure.

Keywords: DMOS-transistors, threshold voltage, doping, p-n transition.

Особливістю ПМОН-структур (рис.1) є нерівномірне легування *р*-канальної області, що слугує підкладкою, як в глибепітаксійному шару, так і вздовж поверхні (рис.2).

Загальний вигляд значення порогової напруги МОН-транзистора відомий [1]:

$$U_{\text{пор}} = U_{\text{пл.3}} + \varphi_{\text{пов}} + \frac{q}{C_{ok}} \int N(x, y, z) dx dy dz, (1)$$

де $U_{пл.3}$ – напруга плоских зон, $\phi_{пов}$ – вигин зон на поверхні, що відповідає сильній інверсії, C_{ok} – питома ємність підзатворного окислу, q – заряд електрона, N(x,y,z) – функція розподілу домішок у підкладці.

Нерівномірний розподіл акцепторних домішок у *p*-канальній області структури приводить до того, що напруга інверсії типу провідності вздовж її каналу є величиною, що залежить від координати локальної ділянки каналу. Тому значення порогової напруги структури, що визначається окрім інших чинників її опором у відкритому стані, буде відрізнятися від напруги відпирання транзистора [2].

Очевидно, що напруга відпирання ПМОНтранзистора визначаться локальною ділянкою *p*-канальної області структури з максимальним значенням поверхневої концентрації результуючої домішки. Визначимо це значення припустивши, що розподіл донорної і акцепторної домішок вздовж границі розподілу Si–SiO₂ у *p*-канальній області структури носить експоненційний характер.



Рис. 1 Поперечний переріз ПМОН-структури.



Рис. 2 Розподіл донорної, акцепторної і результуючої домішки у транзисторній структурі, сформованої методом подвійної дифузії.

Згідно [3] дифузійні профілі іонів фосфору N_d^+ , що утворюють витік *n*-канального ПМОН-транзистора містять дві ділянки: – майже плоска ділянка з концентрацією

$$N_d^{+} = N_d^{+}(x) \le N_d(x_1) \cong 5 \cdot 10^{19} \,\mathrm{cm}^{-3} \,, \quad (2)$$

де *x*₁≈0,8 мкм;

– ділянку з майже експоненційним спадом концентрації

$$N_d(x) = N_d(x_1) \exp[-(x - x_1)L_d],$$
 (3)

де характеристична довжина в розподілі донорів виражена співвідношенням:

$$L_d = \frac{x_{\rm BO} - x_1}{\ln[N_d(x_1) / N_d(x_{\rm BO})]}.$$
 (4)

Розподіл домішок у *p*-канальній області структури сформованої перерозподілом бору з кінцевого джерела, утвореного іонним легуванням, також можна апроксимувати експонентою при $N_a(x) \le 10^{18}$ см⁻³. Для реальних структур в точках металургійного витокового *p-n* переходу $x_{во}$ концентрація акцепторної домішки $N_a(x_{во})$ складає $10^{17}-10^{18}$ см⁻³. Тому для профілю від'ємно заряджених іонів бору у *p*-канальній області структури можна записати:

$$N_a(x) = N_a(x_{\rm BO}) \exp[-(x - x_{\rm BO})/L_a],$$
 (5)

де $L_a = \frac{L_k}{\ln[N_a(x_{BO})/N_{dc}]}$ – характеристич-

на довжина в розподілі акцепторів,

$$L_k = x_{\rm co} - x_{\rm BO} \tag{6}$$

– довжина каналу ПМОН-транзистора.

Отже, результуючий розподіл домішок у *p*-канальній області ПМОН-транзистора матиме вигляд:

$$N_p(x) = N_a(x_{\rm BO}) \exp\left(-\frac{x - x_{\rm BO}}{L_a}\right) - N_d(x_1) \exp\left(-\frac{x - x_1}{L_d}\right).$$
(7)

Положення точки x_m , що відповідає максимальному значенню результуючої концентрації домішок $N_p(x_m)$, можна визначити із умови:

$$\frac{dN_a(x)}{dx}\Big|_{x=x_m} = 0.$$
 (8)

Значення x_m і $N_p(x_m)$ дорівнюють:

$$x_{m} = L_{k} \frac{\ln(L_{a}/L_{d})}{\left(\frac{L_{a}}{L_{d}} - 1\right) \ln(N_{a}(x_{BO})/N_{dc})} + x_{BO}, (9)$$

$$N_{p}(x_{m}) = N_{a}(x_{BO}) \exp\left(-\frac{x_{m} - x_{BO}}{L_{a}}\right) - N_{d}(x_{1}) \exp\left(-\frac{x_{m} - x_{1}}{L_{d}}\right). (10)$$

На рис.3 наведені залежності розподілу результуючої домішки у p-канальній області ПМОН-структури від координат і концентрації домішок у вихідному епітаксійному шарі. Із отриманих результатів слідує, що максимальним значенням концентрації результуючої домішки у p-канальній області структури при заданій довжині каналу можна керувати підбором профілів її легування.

Латеральний розподіл результуючої домішки у *p*-канальній області ПМОН-структури при різних значеннях довжини каналу, концентрації домішок у вихідній кремнієвій підкладці і на металургійній границі витокового *p-n* переходу наведений на рис.4.



Рис. 3. Залежності розподілу результуючої домішки у *p*-канальній області ПМОН-структури від координат і концентрації домішок у вихідному епітаксійному шарі (а) і на металургійній границі витокового *p-n* переходу (б).





Рис. 4. Латеральний розподіл результуючої концентрації у *p*-канальній області ПМОН-структури при довжині каналу: <u>1</u> – 0,5 мкм, <u>2</u> – 1 мкм, <u>3</u> – 1,2 мкм, <u>4</u> – 1,5 мкм.

Для напруги інверсії типу провідності в точці *х р*-канальної області структури можна записати [4]:

$$U_{\rm ihb, np.}(x) = \varphi_{\rm MZII} + 2\frac{kT}{q} \ln \frac{N_p(x)}{n_i} - \frac{Q_{\rm ok}}{C_{\rm ok}} + \frac{2}{C_{\rm ok}} \sqrt{\varepsilon_{\rm Si} \varepsilon_0 N_p} \left| \frac{kT}{q} \ln \frac{N_p(x)}{n_i} \right|, (11)$$

де Q_{ok} – густина заряду на границі розділу Si–SiO₂, $\varphi_{MД\Pi}$ – різниця робіт виходу електронів із затвору і підкладки, ε_{Si} – діелектрична проникність кремнію, ε_0 – діелектрична стала, C_{ok} – питома ємність підзатворного діелектрика, kT/q – температурний потенціал, $N_p(x)$ – максимальне значення концентрації домішок бору в *p*-канальній області, n_i – концентрація власних носіїв в Si.

На рис.5 наведені залежності напруги інверсії типу провідності від координати *х р*канальної області для ПМОН-транзисторів, виготовлених на епітаксійних структурах з орієнтацією поверхні (111) і (100).

На наведених залежностях видно, що однакові значення напруги відпирання транзисторів, виготовлених на епітаксійних структурах з орієнтацією поверхні (111) можна отримати при більш високих концентраціях домішок у металургійних точках витокового *p-n* переходу, ніж для транзисторів, виготовлених на епітаксійних структурах з орієнтацією поверхні (100). Це обумовлено більш високою щільністю позитивного заряду в оксиді кремнію на межі розділу Si–SiO₂.



Рис. 5. Залежності напруги інверсії типу провідності локальної ділянки *p*-канальної області структури від координати для вихідних кремнієвих підкладок з орієнтацією поверхні (100) і (111) при $N_a(x_{\rm B0})$ =5·10¹⁷ см⁻³, N_{dc} =1,5·10¹⁵ см⁻³ для L_k =0,5 мкм (а) і 1 мкм (б).

Отже, транзистори виготовлені на епітаксійних структурах з орієнтацією поверхні (111) матимуть більш високі напруги змикання стоку і витоку у порівнянні з транзисторами, виготовленими на епітаксійних структурах з орієнтацією поверхні (100), при однакових значеннях довжини їх каналів і порогових напруг.

Зробимо оцінку величини напруги змикання стоку і витоку ПМОН-структури з урахуванням експоненційного розподілу домішок фосфору і бору у *p*-канальній області структури.

Умову рівності нулеві повного об'ємного заряду в стоковому *p-n* переході, а також співвідношення між зовнішнім оберненим зміщенням і щільністю збідненого заряду можна записати так:

$$\int_{y'_c}^{y_c} \rho(y) dy = 0, \qquad (12)$$

$$\int_{y_c}^{y_c} y \rho(y) dy = \varepsilon_0 \varepsilon_{\mathrm{Si}} \left(\varphi_{kc} + \left| U_{c_{p-n}} \right| \right), \quad (13)$$

де $y=x-x_{co}$ – координата, що відраховується від металургійної границі стокового *p-n* переходу, $y'_{c} = x'_{c} - x_{co}$, $y''_{c} = x''_{c} - x_{co}$ – межі збіднених шарів стокового *p-n* переходу у *p*-канальній і стоковій областях структури (рис.1), $\rho(y) = q[N_d(y + x_{co}) - N_a(y + x_{co}) + N_{dk}]$ – густина об'ємного заряду, U_{cp-n} – напруга обернено зміщеного стокового *p-n* переходу, φ_{kc} – контактна різниця потенціалів у стоковому *p-n* переході.

З врахуванням (4) i (6) можна записати

$$N_d(y) = N_{dk} \exp\left\{\left(\frac{1}{L_a} - \frac{1}{L_d}\right) - \frac{y}{L_d}\right\}, \quad (14)$$
$$N_a(y) = N_{dk} \exp\left(-\frac{y}{L_d}\right). \quad (15)$$

Тобто для густини об'ємного заряду можна записати:

$$\rho(y) = qN_{dc} \left\{ \exp\left[L_k \left(\frac{1}{L_a} - \frac{1}{L_d}\right) - \frac{y}{L_d}\right] - \exp\left(-\frac{y}{L_d}\right) + 1 \right\}.$$
 (16)

Інтегруючи (12) і (13) з врахуванням

$$\exp\left(-\frac{y_{c}''}{L_{d}}\right) << \exp\left(-\frac{y_{c}'}{L_{d}}\right),$$
$$\exp\left(-\frac{y_{c}''}{L_{a}}\right) << \exp\left(-\frac{y_{c}'}{L_{a}}\right)$$

отримуємо:

 $L_d($

$$L_{d} \exp\left\{W_{k}\left(\frac{1}{L_{a}}-\frac{1}{L_{d}}\right)\right\} \exp\left(-\frac{y_{c}'}{L_{a}}\right) - L_{a} \exp\left(-\frac{y_{c}'}{L_{a}}\right) + y_{c}'' - y_{c}' = 0, \quad (17)$$
$$L_{d} + y_{c}') \exp\left\{W_{k}\left(\frac{1}{L_{a}}-\frac{1}{L_{a}}\right)\right\} \exp\left(-\frac{y_{c}'}{L_{a}}\right) + \frac{1}{L_{a}} \exp\left(-\frac{y_{c$$

$$+ L_a(-y'_{c} - L_a) \exp\left(-\frac{y'_{c}}{L_a}\right) +$$

$$+\frac{1}{2}(y_{c}''^{2}-y_{c}'^{2})=\frac{\varepsilon_{o}\varepsilon(\varphi_{kc}+U_{c_{p-n}})}{qN_{d}}$$

При змиканні стокового і витокового *p-n* переходів $-x'_{c} = L_{k} + x_{BO}$ (витік замкнутий з *p*-канальною областю), тому:

$$L_d^2 \exp \frac{L_k}{L_a} + \frac{1}{2} \exp \left(\frac{2L_k}{L_a}\right) L_a^2 \left(1 - \frac{L_d}{L_a}\right) = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_{\text{Si}}(\varphi_{kc} + |U_{\text{cB3}}|)}{qN_{dc}}, \quad (18)$$

або

$$L_{d}^{2} \frac{N_{a}(x_{\rm BO})}{N_{dc}} + \frac{1}{2} L_{a}^{2} \left(\frac{N_{a}(x_{\rm BO})}{N_{dc}} \right)^{2} \left(1 - \frac{L_{d}}{L_{a}} \right) = \frac{\varepsilon_{0} \varepsilon_{\rm Si}(\varphi_{kc} + |U_{\rm CB3}|)}{q N_{dc}}.$$
 (19)

Оскільки для реальних структур

$$\frac{N_a(x_{\rm BO})}{N_{dc}} << \left(\frac{N_a(x_{\rm BO})}{N_{dc}}\right)^2, \ \frac{N_a(x_{\rm BO})}{N_{dc}} >> 100$$

і $|U_{cB3}| >> \phi_{kc}$, то першим доданком в лівій частині рівняння та значенням ϕ_{kc} в правій частині можна знехтувати. В результаті отримуємо:

$$\frac{1}{2}L_a^2 \left[\frac{N_a(x_{\rm BO})}{N_{dc}}\right]^2 \left(1 - \frac{L_d}{L_a}\right) = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_{\rm Si} |U_{\rm CB3}|}{qN_{dc}},$$
$$|U_{\rm CB3}| = \frac{q}{2\varepsilon_0 \varepsilon_{\rm Si}} \frac{N_a^2(x_{\rm BO})}{N_{dc} \left[\ln \frac{N_a(x_{\rm BO})}{N_{dc}}\right]^2} \left(1 - \frac{L_d}{L_a}\right)^2.$$

На рис.6 наведені залежності напруги змикання стокових та витокових *p-n* переходів ПМОН-транзисторів від концентрації $N_a(x_{\rm BO})$ при різних довжинах каналу.

Висновки

Розроблена математична модель для напруги відпирання і напруги змикання стокового і витокового *p-n* переходів ПМОНструктури у наближенні експоненційного розподілу домішок фосфору і бору у витоковій і *p*-канальній областях структури.

Показано, що значеннями напруги відпирання ПМОН-транзистора і змикання його стокового і витокового *p-n* переходів можна



Рис. 6. Залежності напруги змикання стокових і витокових *p-n* переходів ПМОН-транзисторів від концентрації $N_a(x_{\rm BO})$ при довжині каналу: 1 – 1,5 мкм, 2 – 1,2 мкм, 3 – 1,0 мкм, 4 – 0,8 мкм, 5 – 0,5 мкм і співвідношеннях $L_d/L_a=1/6$ (а) і $L_d/L_a=1/4$ (б). Концентрація $N_d=5\cdot10^{14}$ см⁻³.

керувати шляхом задання профілів легування структури.

Розроблена модель для напруги змикання стокового і витокового *p-n* переходів дозволяє здійснити оптимальний вибір електрофізичних і конструктивних параметрів епітаксійних шарів для виготовлення потужних високовольтних ПМОН-транзисторів із заданими параметрами.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Крупкина Т.Ю., Романов С.Н. Оптимизация параметров МОП-транзистора по пороговому напряжению. // Электронная техника. Сер. Микроэлектроника. –1985. – Вып.4. – С. 47-54.
- Политанский Л. Ф., Лихобабин Н.П. Эффективное пороговое напряжение ДМОП-транзисторов // Электронная техника. Сер. Полупроводниковые приборы. – 1985. – Вып. 3. – С. 54-56.
- Колесников В.Г., Никишин В.И., Сыноров В.Н. и др. Кремниевые планарные транзисторы: научное издание / Под ред. Я.А. Федотова. – М.: Советское радио, 1973.
- Валиев К.А., Кармазинский А.Н., Королев М.Р. Цифровые схемы на МДП- транзисторах. – М.: Советское радио, 1971.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2011. Том 1, випуск 1. Фізика. Електроніка.